

適用規格					
定 格	使用温度範囲	-35℃ ～ +85℃（注1）	保存温度範囲	-10℃ ～ +60℃（注3）	
	使用湿度範囲	40% ～ 80%（注2）	保存湿度範囲	40% ～ 70%（注3）	
	電 圧	AC 250 V	適合コネクタ	DF1B-*S-2.5R	
	電 流	AWG20～24：3A AWG26：2A AWG28：1A AWG30：0.5A			
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構造	外観、構造、仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
電氣的性能	低電圧、低電流下の接触抵抗	100 mA（DC又は 1000 Hz）で測定する。	30 mΩ 以下	○	—
	絶縁抵抗	DC 500 Vで測定する。	1000 MΩ 以上	○	—
	耐電圧	AC 650 Vの電圧を 1 分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	—
機械的性能	繰り返し動作	50 回の抜き差しを行う。	①接触抵抗：30 mΩ 以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐振性	周波数 10～55 Hz、片振幅 0.75 mmで 3 方向 各 2 時間試験する。	① 1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、 正弦半波 3方向 各 3 回試験する。	① 1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
環境的性能	定常状態の耐湿性	温度 40 ± 2℃、湿度 90～95 %中に 96 時間放置する。	①接触抵抗：30 mΩ 以下 ②絶縁抵抗：1000 MΩ 以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	温度サイクル	温度 -55 → +5～+35 → +85 → +5～+35℃ 時間 30 → 5以内 → 30 → 5以内 分 を 5 サイクル試験する。△1	①接触抵抗：30 mΩ 以下 ②絶縁抵抗：1000 MΩ 以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	半田耐熱性	【フローはんだ付けの場合】 はんだ温度 260℃、 浸漬時間 5秒間のはんだ付けを行う。 【手はんだ付けの場合】 はんだごてで300℃、3秒の条件にて はんだ付けを行う。 但し、端子に力を加えないこと。	外観の変形及び端子等に 著しいガタがないこと。	○	—
	半田付け性	半田温度 235 ℃、 浸漬時間 5秒間の半田付けを行なう。	半田浸漬面の 95 %以上が 新しい半田で濡れていること。	○	—
備考					
(注1) 通電時の温度上昇を含む。					
(注2) 結露のないこと。					
(注3) 基板搭載前の未使用品に対する長期保存状態に適用。 基板搭載後、輸送時の一時保管は使用温湿度範囲を適用。					
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△1	1	DIS-H-00001997	HK. HAYASHI	TS. FUKUSHIMA	16. 09. 05
試験規格の記載のない試験方法はIEC 60512(対応規格JIS C 5402)を適用している。			承認	KJ. KATAYOSE	05. 01. 05
			検 図	TY. OMA	05. 01. 05
			担 当	TS. KUMAZAWA	05. 01. 05
			製 図	TS. KUMAZAWA	05. 01. 05
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目		図番	SLC4-071496-00		
HRS	製品規格表		製品名	DF1B-*P-2.5DS (01)	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL541	△1 1/1